산업통상자원부 MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보 도 자 료

희망의 대한민국 http://www.motie.go.kr

2013년 10월 25일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의: 전자부품과 김정일 과장(02-2110-5390), 박용민 서기관(5249)

제6회 「반도체의 날」 기념식 및 「반도체산업발전위원회」 개최

- 대·중소 동반성장에 대한 협력업체 만족도 4.1점(5점 만점) 등 실적점검 결과 발표 -

1 제6회 『반도체의 날』 기념식 개최

□ 대한민국 대표 수출 품목이자 국가 경제를 견인하고 있는 반도체 산업의 성과와 위상을 대외에 홍보하고, 반도체 산·학·연의 노고를 격려하는 화합의 장이 펼쳐짐

○ '13.10.24(목) 오후 서울 여의도 63시티에서 **윤상직 산업통상자원부 장관**을 비롯하여 반도체산업협회장(전동수 삼성전자 사장), 박성욱 SK하이닉스 대표 등 산·학·연 관계자 500여명이 참석한 가운데, **제6회 「반도체의 날」 기념식**이 개최되었음

○ 「반도체의 날」은 반도체 수출이 최초로 100억불을 돌파한 1994년 10월을 기념하여 2008년부터 개최되고 있으며, 올해로 여섯 번째를 맞이하고 있음

□ **산업통상자원부 윤상직 장관**은 축사를 통해 그간 우리 반도체 산업이 이루어온 성과를 격려하는 한편, 급변하는 시장 환경에 맞서 협력적 생태계를 구축함으로써, **"진정한 반도체 최강국으로 도약"**하자고 강조하였음

○ 이를 위해 정부는 핵심장비 개발, 원천기술 선점, 해외시장 진출, 반도체 클러스터 구축 등 **우리 반도체 산업의 지속적인 성장을 견인하는 정책을 적극 추진**해 나가겠다고 강조함

□ 금번 행사에서는 **반도체 산업발전 및 기술개발**을 위해 각고의 노력을 기울인 **반도체 산업 유공자 53명에 대한 포상**도 진행되었음

* 정부 포상(총33점) : 은탑훈장(1), 동탑훈장(1), 산업포장(1), 대통령표창(2), 국무총리표창(3), 산업부장관 표창(25)

○ 동부하이텍 박용인 사장이 파운드리 산업발전에 기여한 공로로 은탑산업훈장을, 전량 수입되던 핵심 소재인 팰리클(감광원판 보호 필름)을 국산화한 에프에스티 장명식 대표가 동탑 산업훈장을 수상하였음

○ 또한 세계 최초 3차원 NAND를 개발한 삼성전자 이운경 상무가 산업포장을, 20나노급 D램·NAND 핵심기술을 개발한 SK하이닉스 곽노정 상무와, 전량 수입에 의존하던 블랭크 마스크를 국산화한 에스앤에스텍 남기수 대표가 대통령 표창 수상의 영예를 안았음

○ 이밖에도 반도체 선행공정기술 개발에 기여한 KAIST 장홍영 교수를 포함한 3명이 국무총리 표창을, 성균관대학교 한태희 교수 등 25명이 산업부장관 표창을 수상하였고, 반도체 산업발전을 위해 각계에서 헌신한 유공자에 대한 공로상(협회장상 20점) 수여도 이루어짐

2 『제1회 반도체산업발전위원회』 개최

□ 반도체의 날 기념식에 앞서 정부와 업계는 산업통상자원부 김재홍 차관 주재로 「**2013년 반도체산업발전위원회」를 개최**하여, **반도체 산업의 동반성장 성과를 점검하고 발전방향을 논의**함

○ 지난 7월 「반도체·디스플레이 협력 생태계 협약」 체결 시, 반도체 산·학·연은 정기적인 동반성장 실적 점검과 발전방향 논의에 합의한 바 있으며,

○ 이에 따라 정부와 한국반도체산업협회는 대기업과 장비·재료 중소 협력사를 대상으로 서면조사를 실시하여, 공동 연구개발, 납품단가

현금 및 납기 內 지급 현황, 협력사 경영지원 등 총 5개 분야에 걸쳐 주요 동반성장 실적을 점검하였음

* 조사 대상기간 : '12.1월~'13.6월(1년 6개월)
조사 대상·방법 : 대기업(3社)-서면질의, 1·2·3차 협력사(200社)-설문조사
조사 기관 및 기간 : 한국반도체산업협회 / '13.8~9월

〈 실적 점검결과 〉

□ **(체감 만족도)** 대기업의 동반성장 프로그램에 대한 **중소 협력기업들의 체감 만족도는 4.1점(5점 만점)**으로 나타나, 지난 5월 동반성장위에서 발표한 반도체 대기업 2개社의 동반성장지수 평가*와 유사하고, 상대적으로 디스플레이 분야(만족도 3.7점)에 비해서도 긍정적인 결과를 나타냄

* 매우 불만족(1점), 다소 불만족(2점), 보통(3점), 다소 만족(4점), 매우 만족(5점)
* '13.5월 대기업 동반성장지수(우수/양호/보통/개선) : 삼성전자-우수, SK하이닉스-양호

□ **(우수분야)** 협력기업들은 **거래조건 개선에 대해 가장 긍정적**인 평가를 내렸으며, **인력 교육·채용 지원, 유휴특허 이전** 등에 대해서도 긍정적인 반응을 보임

○ 구체적으로 살펴보면, 전체 응답기업의 90% 이상이 납품대금의 현금지급(93%) 및 법정기한 內 지급(95%)이 잘 이루어지고 있거나 개선중이라고 응답하였음

○ 또한, 협력사에 대한 교육 및 채용 지원도 활발히 이루어져 총 7,080명(디스플레이 4,607명)의 협력업체 인력이 수혜를 입었고,

○ 대기업이 보유중인 유휴특허를 협력사에 무상 제공한 실적(327건)도 상대적으로 양호한 것으로 파악되었음

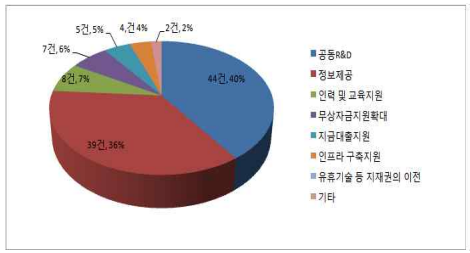
□ **(개선 필요 분야)** 그러나, **국산 장비·소재 구매율, 대·중소 공동 R&D, 인력 이동** 등의 분야에서는 지속적인 개선이 필요한 것으로 조사되었음

○ 조사대상 기간 內 전체 장비·재료 구매액 중 국산 제품의 비중은 35%(11.1조원, 디스플레이 67%)로서, 향후 국산 장비·재료 등의 구매를 확대하고 품질 향상을 지원할 필요가 높은 것으로 나타남

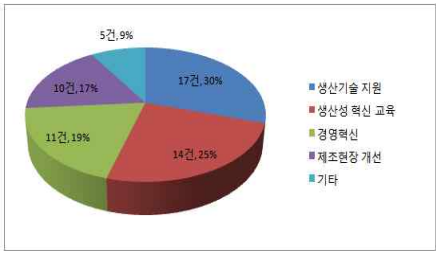
○ 또한, 같은 기간 소자 대기업과 협력기업간 공동 R&D 규모는 디스플레이 분야(83건, 1,320억원)에 비해 매우 적은 38건, 285억원에 불과하여, 대·중소 공동 R&D에 대한 대기업의 더 큰 관심이 필요한 것으로 나타남

○ 협력업체에서 대기업으로 인력이 이동한 사례(23건) 중에서 협력업체의 동의를 얻지 않거나 사전 통보 없이 이동한 사례(15건 65%, 디스플레이 43%)도 적지 않아 개선이 필요함

□ 한편, 대기업의 동반성장 프로그램과 관련하여 1차 협력업체들은 공동 R&D 확대, 정보제공(투자계획·기술로드맵 등) 등을, 2·3차 협력기업들은 생산기술 지원, 생산성 혁신 교육, 경영혁신에 대한 지원 등을 주로 희망하고 있는 것으로 나타남



<1차 협력기업 희망사항>



<2·3차 협력기업 희망사항>

○ 아울러, 정부에 대해서는 대·중소기업의 동반자 관계가 정착될 때까지 적극적인 관심과 지원을 희망(21社)하였으며, 대·중소기업간 공동 R&D 확대를 위한 환경조성(12社), 우수인력 확충(10社) 등을 위해서도 노력해줄 것을 건의하였음

〈 향후계획 〉

□ 금번 조사 자료는 향후 동반성장위원회의 동반성장 지수 평가('14년) 時 참고자료로 활용될 예정이며, 주기적인 실적점검을 통해 他산업의 모범이 되는 **발전지향적 동반성장 프로그램으로 육성**해나갈 방침임 (매년 1~2회 정기 점검)

○ 특히, 제시된 건의사항 중 대다수 협력업체들이 희망하는 정보제공(투자계획·기술로드맵 등) 기회 확대를 위해, 산업부는 반도체협회, 소자 대기업 3社 등과 합동으로 연내에 「반도체 기술로드맵 세미나」를 개최하겠다고 밝힘

별첨1. 제6회 「반도체의 날」 기념식 개요
별첨2. 「반도체산업발전위원회」 개요
별첨3. 반도체 상생협력 주요 점검결과

별첨 1 제6회 「반도체의 날」 기념식 개요

□ 개최배경

○ 국가 주력 산업인 **반도체 산업의 성과와 위상을 대외에 홍보**하고, 반도체 **산·학·연의 노고를 격려**하는 **「반도체의 날」** 기념식을 개최

* '반도체 수출 100억불 달성('94.10.29)을 기념하여 제정, 2008년 1회 행사 개최

□ 개요

○ **일시/장소** : '13.10.24(목) 18:00~20:00 / 63시티 그랜드볼룸

○ **참석자** : 산업부 장관, 노영민 의원, 삼성전자 전동수 사장(협회장), SK하이닉스 박성욱 사장 등 산·학·연 관계자 500여명

□ 주요 행사내용

구 분	시간		주요 내용
리셉션	17:00~18:00		▪ 참석자 등록 및 포토 이벤트 등
opening	18:00~18:05		▪ 오프닝 공연
기념식	18:05~18:40		▪ 1부 기념행사
	18:05~18:07	개회 국민의례	▪ 국민의례
	18:07~18:10	개회 VIP소개	▪ 참석 내/외빈 소개
	18:10~18:15	개회 환영사	▪ 한국반도체산업협회 회장
	18:15~18:20	개회 **축 사**	▪ **산업통상자원부 장관**
	18:20~18:40	유공자 포상	▪ **정부포상(33)** – **은탑훈장(1), 동탑훈장(1), 산업포장(1), 대통령 표창(2), 국무총리 표창(3), 산업부장관 표창(25)** ▪ 민간포상(20) – 협회장상(20)
	18:40~19:50		▪ 2부 축하 리셉션
	18:40~	만 찬	▪ 만찬 개시
	19:00~19:10	건배사	▪ 업계 원로
	19:10~19:35	공연 및 행운권 추첨	▪ 공연 및 행운권 추첨
	19:35~19:50	폐회선언	▪ 폐회 선언

참고 반도체의 날 정부포상자 명단

□ **정부포상** : 훈장(2), 산업포장(1), 대통령표창(2), 국무총리표창(3), 산업부장관표창(25) 등 총 33점

포상훈격		소 속 및 직급	성명 (생년월일)	수공 기간	공적 개요
산업훈장 (은탑) (1)		동부하이텍 사장	박용인 (64.4.23)	26년 6개월	· 아날로그 반도체기술의 전문화를 통해 국내 파운드리 산업발전 기여 · 국내 팹리스 기업의 경쟁력 향상 및 해외 진출 적극 지원
산업훈장 (동탑) (1)		에프에스티 대표이사	장명식 (53.12.18)	25년 8개월	· 전량 수입 중이던 반도체 수율 향상의 핵심 소재인 팰리클의 국산화 및 수입 대체 효과에 기여
산업포장 (1)		삼성전자 상무	이운경 (65.1.3)	21년	· 세계 최초 3차원 수직 배열 V-NAND 메모리 개발 및 상용화
대통령표창 (2)		SK하이닉스 상무	곽노정 (65.11.6)	18년 10개월	· 20나노급 차세대 D램·NAND에 필요한 핵심기술 및 선행공정 개발에 기여
		에스앤에스텍 대표이사	남기수 (52.4.11)	37년	· 전량 수입에 의존하던 블랭크 마스크 국산화를 통한 수입 대체 및 수출
국무총리표창 (3)		KAIST 교수	장홍영 (54.1.5)	25년 7개월	· 반도체 선행공정기술 개발 및 기술이전을 통해 중소기업의 사업화에 기여
		삼성전자 부장	김학진 (61.10.29)	24년 1개월	· 다수의 국가 R&D 사업 기획/운영 및 중소기업 지원을 통해 대중소 상생협력에 기여
		LG전자 연구위원	백우현 (61.10.2)	26년 5개월	· 세계 최초 지상파 DMB 수신 SoC 개발을 통해 단말기 시장 확대에 기여

포상훈격	소 속	직급	성명 (생년월일)	수공 기간	공적 개요
산업부 장관표창 (25)	성균관대학교	교수	한태희 (70.9.2)	14년	· 산업융합원천기술개발사업, 시스템반도체상용화 기술개발사업 등을 기획총괄하여 시스템반도체 경쟁력 향상에 기여
	ETRI	책임	주유상 (60.6.9)	26년 5개월	· ASIC 설계인력 양성으로 시스템반도체 산업 육성에 기여
	라온텍	상무	조성재 (71.7.14)	16년	· 세계최초로 Mobile TV Multi-standard SoC 기획, 개발 추진하여 반도체산업발전에 기여
	SK텔레콤	부장	황준호 (68.8.10)	17년	· 한-중시스템IC협력연구원 사무국장으로서 국내 팹리스 기업의 중국 시장 안착에 기여함
	메카로닉스	부사장	정태성 (64.3.25)	21년	· 반도체 CVD공정의 핵심부품소재인 Heater Block과 Precursor를 개발 및 국산화
	ASML코리아	상무	여태문 (66.7.15)	30년 4개월	· Scan&Stepping 기술, Immersion 노광기술 도입을 통하여 집적도 향상 및 대구경화를 통한 생산성 확대로 세계시장 선점
	엑시콘	차장	조원호 (72.04.05)	8년 8개월	· 반도체 기업 혁신능력 강화, 산학협력 체계 구축 등을 통한 반도체 산업 발전 기여
	앰코테크놀로지코리아	전무	황재현 (58.11.4)	29년 2개월	· 신규/첨단 PKG에 대한 전략적인 투자, 지원 및 효율적인 자원 이용을 통해 반도체 후공정 발전에 공헌
	성도이엔지	사장	정재근 (60.1.16)	26년 2개월	· 반도체설비인 크린룸 UHP System의 중앙 약액 공급장치(C.C.S.S) 수입 대체 및 세계 최고의 기술로 발전시키는데 크게 기여
	한국반도체산업협회	책임	임세준 (75.6.4)	6년 6개월	· 중소기업 지재권 지원사업을 성공적으로 수행·관리하였으며, 중소기업의 특허분쟁 대응, 특허인식 제고 등에 공헌
	한미반도체	이사 대우	김영환 (73.10.5)	14년 3개월	· 국내최초로 Sawing & Placement System의 개발 및 상용화
	서강대학교	교수	범진욱 (64.12.19)	15년 2개월	· PAM기술을 적용한 고속데이터송수신회로를 초저전력으로 구현
	세메스	수석	최시용 (70.10.15)	18년 8개월	· 국내 최초로 Prober Station개발과 세계최초로 OLED 핵심 검사장비인 ICP를 개발하는 등 기술 발전에 크게 공헌
	피에스케이	수석	이창원 (69.11.15)	16년	· 다수의 반도체 표면처리장비의 국산화, 수출 확대에 기여
	실리콘화일	책임	김희걸 (75.11.27)	12년 2개월	· 1.4um pixel을 이용한 1/5" 3M이미지 센서 개발로 수입 대체효과
	동진쎄미켐	부장	박종대 (71.1.21)	18년 4개월	· 반도체 제조 공정 소재 신물질 개발을 통해 수입대체 효과 창출
	SK하이닉스	수석	이주엽 (69.4.4)	17년 4개월	· 20나노 선폭의 고성능 낸드플래시 제품 솔루션 개발을 통하여 생산성 향상
	삼성전자	수석	고명룡 (63.10.19)	24년 3개월	· Smart-Phone의 핵심 부품인 전력 반도체 Chip을 최초 국산화에 성공 하여 전력 반도체 분야 경쟁력에 크게 기여함
	충북대학교	교수	조경록 (55.6.10)	20년	· 4번째 소자로 알려진 Memristor 소자의 모델링 하여 나노소자의 SoC 설계 기술을 크게 발전
	원익아이피에스	부장	김용진 (74.5.16)	12년 6개월	· 반도체 前 공정 장비 국산화 개발 및 상품화와 독창적인 기술력을 발휘하여 신제품 개발.
	테스	이사	정진옥 (70.1.1)	20년 5개월	· 반도체 전공정 장비인 기상증착 장비개발을 주도하여 양산화까지 성공
	연세대학교	교수	조만호 (66.3.25)	17년 2개월	· 미래 반도체 소자의 front-end 단위 공정 및 관련 측정/분석 분야의 연구와 반도체 산업을 위한 다양한 정책활동을 통해 반도체 산업 발전에 기여함
	삼성전자	수석	박준식 (64.6.19)	29년	· 차세대 설비 개발 및 성능향상
	SK하이닉스	수석	한상준 (66.9.27)	17년 4월	· 반도체 공정 정밀 측정 장치인 오버레이 장치 개발 및 국산화
	나노세미콘	대표	유정호 (70.6.27)	25년 3월	· Foup Cleaner 장비 개발 및 국산화 (전국품질경연대회 금상 수상)

별첨 2 「반도체산업발전위원회」 개요

□ **(추진 배경)** 반도체 산업발전을 위한 정책방향 논의 및 협력 생태계 조성 성과 점검 등을 위한 산·학·연·관 산업발전위원회 개최

○ 지난 7월 체결된「반도체·디스플레이 협력 생태계 협약」합의 내용 中 정기적인 동반성장 실적 점검을 실천

* 디스플레이는 10.1(화) 상생협력위원회 기 개최

□ **(위원회 구성)** 민·관 공동위원장을 포함한 17명으로 구성

○ (위원장) 민·관 공동위원장(산업부 차관, 김형준 서울대 교수)

○ (위원) 삼성전자, SK하이닉스 등 대기업 3社, 수요 기업, 장비·소재 기업 및 팹리스 기업, 학계, 전품연·ETRI 등 15명

□ **행사 개요**

○ 일시 : '13. 10. 24일(목), 16:30 ~ 17:45

○ 장소 : 63시티 사이프러스룸(3F)

○ 세부진행(안)

시간	주요 내용	비 고
~16:25(식전)	▪ 귀빈영접 및 환담	
16:30~16:35(5')	▪ 개회선언 및 참석자 소개	
16:35~16:45(10')	▪ 인사말씀	▸ 산업부 차관 ▸ 김형준 교수
16:45~17:00(15')	▪ 반도체 동반성장 실적 점검	전자부품과장
17:00~17:40(40')	▪ 자유토론 (업계 애로사항 및 발전방안 논의)	주재 : 산업부 차관
17:40~17:43(3')	▪ 기념 촬영	
17:43~17:45(2')	▪ 폐회 선언	

반도체산업발전위원회 위원

번호	소 속	성명	직위	비고
1	산업통산자원부	김재홍	차관	공동 위원장
2	서울대학교	김형준	교수	
3	삼성전자	전동수	사장/협회장	대기업 (3)
4	SK하이닉스	박성욱	대표이사/사장	
5	동부하이텍	최창식	사장	
6	원익	이용한	대표이사/회장	장비 (2)
7	케이씨텍	고석태	대표이사/회장	
8	피케이엘	정수홍	대표이사/회장	소재 (2)
9	동진쎄미켐	이준혁	대표이사/사장	
10	MDS테크놀로지	이상헌	사장	SW
11	실리콘마이터스	허 염	대표이사/사장	팹리스 (2)
12	실리콘웍스	한대근	대표이사/사장	
13	현대자동차	곽우영	부사장	수요 (2)
14	LG전자	안승권	사장/CTO	
15	KETI	김경원	원장	연구소 (2)
16	ETRI	김흥남	원장	
17	서울대학교	김수욱	교수	학계

별첨 3 반도체 동반성장 주요 실적

▪ 조사대상 기간 : '12.1~'13.6월 ▪ 조사방법 : (대기업)서면질의, (1, 2·3차 협력사)설문조사(200개社)

1. 대기업 동반성장 프로그램 만족도 : 4.1점(5점 만점, 디스플레이 3.7)

* 매우 불만족(1점), 다소 불만족(2점), 보통(3점), 다소 만족(4점), 매우 만족(5점)
* '13.5월 대기업 동반성장지수(우수/양호/보통/개선) : 삼성전자-우수, SK하이닉스-양호

2. 기술개발 및 국산화

① 대·중소 공동 R&D(착수 기준) : 38건, 285억원(디스플레이 83건, 1,320억원)

▸ 우수사례 ◂
(SK하이닉스-오로스테크놀러지社) 공동 R&D를 통한 평가 및 꾸준한 인력 지원을 통해 Overlay 장비 국산화에 성공('12.7월), 연 100억원의 수입 대체 효과 발생

② 국산 장비·재료 구매실적 : 총 11.1조원(전체 구매금액의 35%, 디스플레이 67%)

▸ 우수사례 ◂
(삼성전자) 이오테크닉스와 공동으로 전량 수입에 의존하던 반도체 절단에 사용되는 스텔스다이싱(Stealth Dicing) 장비 개발 및 구매(105억원)

③ 대기업의 협력사 장비·재료·부분품 성능평가 실적 : 총 39건

* SK하이닉스(15건), 삼성전자(14건), 동부하이텍(10건)

3. 공정거래 및 인력이동

① 원자재 인상 등을 반영한 납품단가 인상·유지 실적 : 3,351억원(전체 구매액의 3%)

② 납품대금 현금지급(93%), 법정기한 內 지급(95%) 관련 긍정적 응답 다수

③ 협력사 동의 또는 사전 통보 없이 대기업으로 인력 이동 : 15건(전체의 65%)

* 인력이동 사례(총 112건) : 중소기업간 이동(60.6%), 협력사→대기업(23.2%), 기타(16.1%)

4. 경영지원

① 협력사에 대한 자금 지원규모 : 약 3,360억원(디스플레이 3,400억원)

② 협력사 인력 교육·채용 지원 실적 : 7,080명(디스플레이 4,607명)

③ 대기업 유휴특허의 협력사 제공 실적 : 327건

5. 지원확대 희망사항

① (1차) 공동 R&D(40%), 정보제공(36%), 인력·교육 지원(7%), 자금 지원(6%) 등

② (2·3차) 생산기술 지원(30%), 인력 교육(25%), 경영혁신(19%), 제조현장 개선(17%) 등